# ⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A)

昭58-222521

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/20 21/263 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 6851-5F ❸公開 昭和58年(1983)12月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## 69半導体膜の形成法

20特

願 昭57—105156

②出 願 昭57(1982)6月18日

⑩発 明 者 関口金孝

所沢市大字下富字武野840シチ ズン時計株式会社技術研究所内

⑪出 願 人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番

1号

明 細 書

1. 発明の名称

半導体膜の形成法

### 2. 特許請求の範囲

- (I) 半導体製造工程におけるレーザーアニールに 於て、2つ以上のレーザ光を用いる事を特徴とす る半導体膜の形成法。
- (2) レーザー光は、1センチメートル以下の照射 距離である事を特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の半導体膜の形成法。
- (3) レーザー光は発振モードが、ガウシアンモードである事を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体膜の形成法。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体膜のレーザーアニーリングに 関する。

現在、レーザーアニール技術は、半導体膜の特性改善に利用されようとしている。内容は、イオンインプラ後の欠陥除去、低温形成した半導体膜の結晶化、不純物ドーピングの際の活性化、絶縁

膜上への結晶化半導体膜形成等である。この内の 結晶性の改善として、基板に凹凸を形成し、形状 効果を利用しようとする方法及び、種結晶を利用 する方法等があるが、現在までの所まだ十分なレ ーザーアニール技術は確立されていない。また、 以上の2つの方法は、工程面及び、基板の制約も あり、広く応用できる技術ではない。

最近、レーザーアニール技術において、レーザー照射部での冷却過程が、結晶性に大きく影響し、 照射部で内側より冷却された場合に、結晶性及び、 表面の凹凸等のない膜が得られるという報告がある。

本発明は、2つ以上のレーザー光を利用し、結晶性を改善し、低温で形成した半導体膜の特性向上をはかるものである。

低温での半導体膜形成法としては、プラズマ或は、低圧における化学蒸着法(CVD法)及び、物理蒸着法(PVD法)さらに高真空を利用した分子線蒸着法(MBD法)等がある。

低温で形成した半導体膜は、結晶性が悪く、単

結晶膜に比べて、電気的特性等において劣ってお り、改善が必要とされている。そこで、2つ以上 のレーザー光を利用し、照射部の温度制御を行な い、結晶性を改良する。結晶性をよくするのに必 要な、温度制御として、レーザー照射部での冷却 が中心より起こり、結晶成長が、中心から周囲に 広がる事が必要である。この1つの方法として、 レーザーの発振モードを変えたり、共振器のミラ - の改造等により、レーザー光の形状を変えて、 レーザーアニールを行なう方法があるが、発振が、 ガウシアンモードと比較して、不安定であり、連 続発振による不安定性によるレーザーアニール膜 の不均一性の問題がある。そこで本発明では、2 つ以上のレーザー光を組み合せ、レーザー光の形 状変化を利用した場合よりも安定で、かつ、照射 部の中心から周囲に結晶化が進み、安定に、結晶 性の優れたレーザーアニールを行なう事ができる。 次に、本発明のレーザーアニールの一実施例を 図を用いて詳細に説明する。

第1図は、レーザー光の組み合せによるエネル

半導体膜を形成した図であり、11が基板、12 が半導体膜、例えば、シリコン、ゲルマニウム等 である。第2図Bは、半導体表面をレーザーアニ ールしている図であり、レーザーの照射は、半導 体膜上から、或は、基板面上から行なってもよい。 13は、レーザーアニールを表わしている。12 は、レーザーアニールを行なった半導体膜である。 第2図Cは、レーザーアニールした膜12上へソー ス或は、ドレイン電極を形成した図であり、14 は、ソース或は、ドレイン電極である。第2図D は、半導体膜の活性領域部、つまり、ソース或は、 ドレイン電極間上へゲート絶縁膜を形成した図で あり、15が、ゲート絶縁膜である。第2図Eは、 ゲート絶縁膜15上へゲート電極を形成した M O S ( 金属酸化膜半導体)型半導体素子を示し た図であり、16が、ゲート電極である。

第3図は、レーザー光の分岐或は、合成の実施例を示す説明図である。第3図Aは、1つのレーザー光東をピイームスプリッタで2つに分離し、反射板例えばアルミニウム板で反射させビームを

ギー強度を示した分布図である。

第1図 A は、ガウシアンモードのレーザー光のスポットの径方向のエネルギー強度分布を表わし、1が、分布曲線である。第1図 B は、レーザー光の中心を d だけ離し、第1図 A の強度のレーザー光を照射した場合のレーザー強度であり、2が、合成したレーザー強度曲線を表わしている。第1図 C は、レーザー光を 3 箇所に照射し、かつ、中央部のレーザー光強度を 3 くした場合をあらわしている。レーザー光の中心は、e だけ離し、合成したもので、3 は、中央部に照射したレーザー光強度、4 は、合成されたレーザー強度をあらわしている。

レーザー光は第1図Bにおける照射距離 d 、第 1図 C における照射距離 e を、1 cm以下にすることにより分布の重なりを得ることが必要である。

第2図は、本発明のレーザーをアニールに利用 した半導体素子製造工程の一実施例を示す断面図 である。

第2図Aは、ガラス或はセラミックス基板上に

基板上で合成させた図であり、21がレーザー光であり、22がビイームスブリッタであり、23が反射板であり、24が基板である。第3図Bは、2つのレーザー光を反射板を用い基板上であり、26及び26が反射板であり、27が基板である。第3図Cは、ダブルイメージブリズム、例えば、Wollastonである。第3図Cに於いて、28は、Wollaston、第3図Cに於いて、28は、Wollaston、第3図Cに於いて、28は、Wollaston、30及び30は、反射板であり、31は、基板である。

以上の方法を利用する事により、レーザー光を 色々な強度分布を有する形状に合成でき、レーザ ーアニール法に広い応用性を持たせる事ができる。 . 図面の簡単な説明

第1図 A )、第1図 B )、第1図 C )は、それぞれ異るレーザー光の組み合せにより生ずるエネルギー強度を示した分布図、

第2図A)より第2図E)は、本発明の合成したレーザー光を利用した半導体素子製造法の工程を示す断面図、

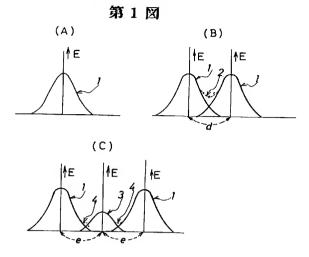
第3図A)より第3図C)は、それぞれの分岐 及び合成によりレーザー光が基板に達する状態を 示す説明図である。

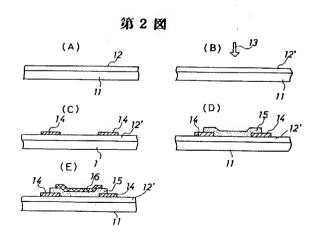
- 1 ……レーザーの強度分布曲線、
- 2……合成されたレーザーの強度分布曲線、
- 11……基板、 12……半導体膜、
- 15……ゲート絶縁膜、 16……ゲート電極、
- 21、25、25′……レーザー光、
- 22……ビイームスプリッタ、
- 24、27、31……基板、
- 28……Wollastonプリズム。

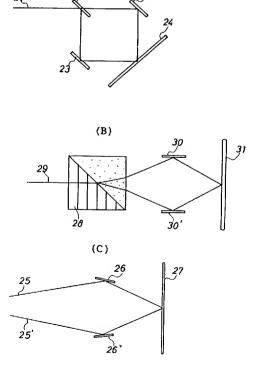
特許出願人 シチズン時計株式会社



第3図







(A)

PAT-NO: JP358222521A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58222521 A

TITLE: FORMING METHOD FOR SEMICONDUCTOR FILM

PUBN-DATE: December 24, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SEKIGUCHI, KANETAKA

#### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
CITIZEN WATCH CO LTD N/A

**APPL-NO:** JP57105156 **APPL-DATE:** June 18, 1982

INT-CL (IPC): H01L021/20 , H01L021/263

US-CL-CURRENT: 117/43 , 117/904 , 257/E21.134 , 438/530 , 438/FOR.153 , 438/

FOR.334

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve crystallinity, and to enhance the characteristics of the semiconductor film formed at a low temperature by using two or more of laser beams in laser annealing in a semiconductor manufacturing process.

CONSTITUTION: Laser intensity in the case when laser beams are irradiated while the center of laser beams, the distribution of energy intensity thereof is shown in a distribution curve 1, is separated only by (d) is shown in a synthetic curve 2. Distribution is overlapped by bringing a distance of irradiation (d) to 1cm or less in laser beams. Regarding the branch or synthesis of laser beams, one laser luminous flux 21 is separated into two by a beam splitter 22, and reflected by reflector plates such as aluminum plates 23, and beams are synthesized on a substrate 24. The method is more stable than the case of the utilization of a change of form of laser beams, crystallization progresses to the periphery from the center of an irradiating section, and laser annealing of excellent crystallinity can be executed stably.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio